

2024年日本东京国际半导体展览会SEMICON JAPAN

产品名称	2024年日本东京国际半导体展览会SEMICON JAPAN
公司名称	苏州京成展览有限公司
价格	99.00/件
规格参数	日本展会:2024
公司地址	苏州市花桥镇绿地杰作大厦9号楼1911室
联系电话	18913292209 18913292209

产品详情

2024日本东京半导体展览会SEMICON JAPAN

展会时间：2024年12月11日-12月13日

展会地点：日本东京有明国际展览中心

主办单位：日本国际半导体设备及材料协会（SEMI）办:日经BP社 电通

展会周期：一年一届

组展单位：上海贸升展览服务有限公司—日本展专业服务商

不参展人员，我司可提供组团观展服务，提供签证，机票，酒店，入场证办理等服务

另我司可代办日本签证（商务，旅游，三年多次，5年多次）材料简单，出签快

展会简介：

日本东京国际半导体电子元器件展览会Semicon

Japan是日本规模*大、*具影响力的类展览会之一。日本东京国际半导体电子元器件展览会Semicon Japan是一个国际化的半导体专项展览会，由Semi举办，该展每年一届在东京举办。

日本向全球半导体制造业供应了三分之一的半导体设备和超过一半的材料。SEMICON Japan位于半导体供应链的核心位置，来自日本和其他地区的750多家参展公司云集于此，为您的技术挑战和业务成功展示创新的解决方案。

参展范围：

- 1、半导体设备和材料、集成电路、半导体分立器件、半导体照明、半导体设备；
- 2、半导体封装设备、半导体扩散设备、半导体焊接设备、半导体清洗设备、半导体测试设备、半导体制冷设备、半导体氧化设备、半导体激光设备等；
- 3、导体分立器件产品与应用技术等；
- 4、半导体光电器件；
- 5、光伏太阳能、多晶硅提纯及辅助设备、晶体硅电池及辅助设备、TFT—LCD设备；
- 6、电子元器件和组件、电子生产设备\ SMT设备（SMT生产线shebao、辅助及检测设备、OKI系列产品、防静电设备）、微组装设备（粘片、键合、清洗、检测、封焊设备）、工业辅料、粘结于密封、涂敷材料、表面处理、润滑产品、焊接辅助材料等。

我司组展优势：

- 1、多年来专注日本展会，可为客户解决突发及疑难问题。
- 2、良好的摊位位置和价格优势。
- 3、境外行程和酒店食宿等安排一向优惠合理便捷，得到广大参展商和商务考察企业单位的****！
- 4、常年操作日本展经验和熟悉当地国家情况的专业带团人员。
- 5、从摊位确认到展台搭建及展览品运输和商务签证培训与补贴办理，公司一条龙的专业服务理念，打造展览服务行业第一品牌！
- 6、在日本设有公司办事处和仓库，可提供展会服务以外的其它相关服务。（如：租车，样品寄存，个人定制旅游等）

随着物联网、新一代移动通信、人工智能等新技术的不断成熟，工业控制、汽车电子等半导体主要下游制造行业的产业升级进程加快，下游高科技领域的技术更新，带动了半导体企业的规模增长。如新能源汽车整车半导体价值将达到传统汽车的两倍，特别是功率半导体的应用大幅增长；在物联网领域，根据Gartner的预测，全球联网设备将从2020年的131亿台上升到2025年的240亿台，复合增长率12.87%。下游科技行业的快速升级，已成为行业新的市场推动力，并且随着国内企业技术研发实力的不断增强，国内半导体行业市场空间将迅速扩大。